

<p>10月31日(木)10:00-12:30</p> <p>KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:30 (受付・ウエルカムコーヒー 9:30 開始)</p>	<p>コース</p>	<p>10月31日(木)14:00-16:40</p> <p>A-1 自動運転/コネクテッドカー実現の最前線</p>	<p>11月1日(金)12:50-15:05</p> <p>A-2 モビリティ進化を支える革新的キーデバイス</p>	<p>11月1日(金)15:35-17:50</p> <p>A-3 次世代車載パワーデバイス</p>
<p>◆来賓挨拶(予定)</p> <p>京都府知事 西脇 隆俊(予定) 京都市長 門川 大作(予定)</p> <p>◆基調講演「HPC(High Performance Computing)活用によるパナソニックのデジタルイノベーション(仮題)」 パナソニック㈱ テクノロジーイノベーション本部 HPCプロモーションセンター 所長 宮嶋 浩志</p> <p>◆基調講演「MRAMコアのAIチップの最前線(仮題)」 東北大学 国際集積エレクトロニクス研究開発センター センター長 遠藤 哲郎</p> <p>◆基調講演「世界経済/政治の激動が続く中でニッポン電子デバイスはどうか」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p>	<p>【A】 次世代自動車</p>	<p>松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)</p> <p>◆次世代自動車の世界市場展望~CASE戦略とイノベーションの動向~(仮題) カノラマジヤパン㈱ 宮尾 健 ◆ホンダのコネクテッドカー「Honda Drive Data Service」(仮題) 本田技研工業㈱ 経営企画統括部 福森 雅 ◆新モビリティ社会創造に向けた取り組み(仮題) ㈱ZMP 代表取締役 谷口 恒</p>	<p>松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープFITオートモティブ)</p> <p>◆「駐車支援/自動駐車システムに向けたビューカメラ/イメージセンサーメーカーのTier2」の動向(仮題) 株式会社経済研究所 名古屋支社 インダストリアルテクノロジーユニット 自動車産業グループ 主任研究員 池山 智也 ◆車載向け距離画像センシング技術の進展 パナソニック㈱ インダストリアルソリューションズ社 技術本部 センシングソリューション開発センター 部長 小田川 明弘 ◆ 未定</p>	<p>石田昌宏(パナソニック)/佐藤 浩史(京都大学)</p> <p>◆シリコンならびにSiCパワー半導体デバイスの最新技術動向 筑波大学 数理物質系 物理工学領域 教授 岩室 憲幸 ◆ 未定 ◆最新世代SiC/IGBTデバイスの紹介と使い分け インフィニオンテクノロジーズ ジャパン㈱ インダストリアルパワーコントロール事業本部 マーケティング&アプリケーションサポート部 ビジネスデベロップメント&マーケティングマネージャー 藤森 正然</p>
<p>11月1日(金)9:30-11:55</p> <p>KM-2 マーケティングセッション 9:30-11:55 (受付 9:00 開始)</p>	<p>【B】 5G・AI・センシング</p>	<p>B-1 5Gの最前線</p> <p>加藤千晴(村田製作所)/岡田吉生(GF)</p> <p>◆5Gで日本はどうなるか(仮題) ㈱NTTドコモ 5G推進室 担当部長 奥村 幸彦 ◆5Gの展望と表面波フィルタ(仮題) ㈱村田製作所 モジュール事業本部 高周波デバイス事業部 副事業部長 芝 雅裕 ◆Beyond 5Gに向けたミリ波・テラヘルツ通信の研究動向 早稲田大学 理工学術院 教授 川西 哲也</p>	<p>B-2 AI向けデバイス</p> <p>岡田吉生(GF)/石田昌宏(パナソニック)</p> <p>◆AIによる材料開発加速の最前線と、ニューロモフィックチップの研究進捗 日本アイ・ビー・エム㈱ 東京基礎研究所 サイエンス&テクノロジー 部長 山道 新太郎 ◆edge AIの最前線と、中小企業がAIを活用するためのシステム提案 シルファルコン・テクノロジー・ジャパン㈱ 代表取締役会長 兼 CEO 西口 泰夫 ◆ 未定</p>	<p>B-3 次世代センシング</p> <p>泉谷 渉(産業タイムズ社)/里松智志(NTTエレクトロニクス)/佐々木元(メガチップス)</p> <p>◆スーパーセンシングフォーラムについて(仮題) 東京大学 大学院工学系研究科 機械工学専攻 センシングヒューマニ ケーションデザイン 社会連携講座 特任教授 中川 聡 ◆フレキシブルデバイスを用いた 生体信号・微小信号計測センサの開発 大阪大学 産業科学研究所 教授 関谷 毅</p>
<p>司会: 松下晋司(㈱産業タイムズ社)</p> <p>◆特別講演「市況減速に直面する半導体デバイスと製造装置、電子部品市場の現状と今後の展望」 ㈱産業タイムズ社 大阪支局 電子デバイス産業新聞 編集部 記者 中村 剛</p> <p>◆特別講演「EV、IoT・AIが半導体産業を牽引する(仮題)」 IHS グローバル㈱ 調査ディレクター 南川 明</p> <p>◆特別講演「今後のFPD業界をどうみるか? (仮題)」 みずほ証券㈱ エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・ テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト 中根 康夫</p>	<p>【C】 最先端半導体飛躍の時</p>	<p>C-1 世界をリードする日本の半導体材料技術</p> <p>酒井滋樹(日新イオン機器)/藤原健典(東レ)</p> <p>◆EUV/リソグラフィとマスク技術の動向 大日本印刷㈱ ファインオプトロニクス事業部 フェロー 林 直也 ◆レジスト材料とEUV技術の動向(仮題) 富士フイルム㈱ エレクトロニクスマテリアルズ研究所 マネージャー 藤森 亨 ◆シリコン基板をベースとした次世代パワーデバイスおよび イメージセンサ向け真空常温接合ウエーハの検討 ㈱SUMCO 評価・基盤技術部 製品基盤技術課 担当課長 古賀 祥泰</p>	<p>C-2 進化を続ける半導体プロセス・装置技術</p> <p>森義弘(SCREEN)/廣田良浩(東京エレクトロ)</p> <p>◆EUV/パターニング技術と課題 東京エレクトロ九州㈱ 開発本部 プロセス技術部 グループリーダー 村松 誠 ◆最先端半導体製造を支える最新洗浄技術 (先端ロジック/メモリーからパワーデバイスまで) ㈱SCREEN セミコンダクターソリューションズ CGS製品統轄部 洗浄技術開発部 部長 高橋 弘明 ◆Enabling applications in IoT era Applied Materials INC, Group Vice President, General Manager, ICAPS Group Sundar Ramamurthy</p>	<p>C-3 5G・AI・IoT時代を支える半導体デバイス・回路技術</p> <p>廣田良浩(東京エレクトロ)/三富士進彦(ローム)/山本浩之(マイクロモリジャパン)</p> <p>◆Spin-Orbitronicsを応用した新型MRAMの紹介(仮題) SPIN-ORBITRONICS TECHNOLOGIES㈱ CEO & CTO 奥田 博明 ◆DRAM& Emerging Memory Technology: Process and Materials Technisight Inc. Technology Intelligence/Senior Technical Fellow Jeongdong Choe ◆アナログ技術の粋を集めた革新的電源IC Nano Seriesの紹介(仮題) ローム㈱ LSI開発部 統括係長 山口 雄平</p>
<p>◆特別講演「EV、IoT・AIが半導体産業を牽引する(仮題)」 IHS グローバル㈱ 調査ディレクター 南川 明</p>	<p>【D】 特別セッション ①</p>	<p>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム</p> <p>戸所義博(イーセップ)/向井雅昭(京都工芸繊維大学)</p> <p>◆Tschomietic nanomachines: Molecular wheel, Vehicles, rotors and motors(仮題) University Paul Sabatier, Toulouse, France, NAISt Professor Gwénaél Rapenne ◆ナノフォトニクスによる光制御技術のデバイス応用 パナソニック㈱ テクノロジーイノベーション本部 センサ・デバイス研究所 スマートオプティクス研究部 部長 平澤 拓 ◆超高压電子顕微鏡による化合物半導体デバイスの解析(仮題) 三菱電機㈱ 高周波光デバイス製作所 品質保証部 井上 晃一 ◆有機エレクトロニクス研究における NAISt-NP 研究支援(仮題) 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学研究所 物質創成科学領域 特任教授 清水 洋</p>	<p>D-2 パッケージング市場動向と最新技術動向 (5G/μLED)</p> <p>藤原健典(東レ)/不破保博(ローム)</p> <p>◆FOWLP/5G/mm波等の最新パッケージに関する市場と技術トレンド について(仮題) ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦 ◆5Gミリ波通信用基板材料およびパッケージング技術 ㈱村田製作所 モジュール事業本部 技術統括部 ネットワーク技術開発部 技術開発4課 リサーチャー 須藤 薫 ◆マイクロLEDに関する実装技術等について(仮題) K&S Singapore 技術統括VP Chan Pin</p>	<p>D-3 最新FOパッケージング・材料・装置関連</p> <p>森川泰宏(ULVAC)/酒井滋樹(日新イオン機器)</p> <p>◆ロームの提案するRD1-first FOWLP ローム㈱ LSI生産本部 RISPAC開発課 次席技術員 西村 勇 ◆FO-PLP JOINTラボについて(仮題) 日立化成㈱ 情報通信事業本部 パッケージングソリューションセンター 開発担当部長 野中 敏央 ◆アルバックのPLP装置について(仮題) ㈱アルバック 電子機器事業部 部長 岩井 治憲</p>
<p>◆特別講演「今後のFPD業界をどうみるか? (仮題)」 みずほ証券㈱ エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・ テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト 中根 康夫</p>	<p>【E】 特別セッション ②</p>	<p>E-1 機器分解による電子部品市場の解析</p> <p>木村匡雄(ソニー)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆スマホを中心としたエレクトロニクス機器の分解調査、動向につ いて(仮題) セミコンサルト 代表 上田 弘孝 ◆ 未定</p>	<p>E-2 米中貿易戦争下の中国半導体動向</p> <p>戸所義博(イーセップ)/神原弘之(ASTEM)</p> <p>◆中国半導体の方向性と展望(仮題) ㈱産業タイムズ社 上海支局長 黒政 典善 ◆米中冷戦下の米国の投資・貿易管理強化の動きと 日中イノベーション協力 (一財)日中経済協会 専務理事 東京工業大学 環境・社会理工学院 CBECプログラム 特任教授 杉田 定大</p>	<p>E-3 先進半導体によるがん治療・診断革命</p> <p>松下晋司(産業タイムズ社)/中村孝(大阪大学)</p> <p>◆シリコン光子増倍素子(SIPM)を用いたPET診断装置 浜松ホトニクス㈱ 中央研究所 第5研究室 副研究室長 大村 知秀 ◆SiCパワーデバイスを用いた革新的BNCTがん治療装置の開発 福島SiC応用技術㈱ 代表取締役 CEO 古久保 雄二 ◆がんの早期発見・早期治療につながる「メタロ・バランス」 がんリスクスクリーニング法について ㈱レナテック 最高顧問 稲垣 精一</p>